

極薄ポリイミドフィルム

カプトン® 20EN

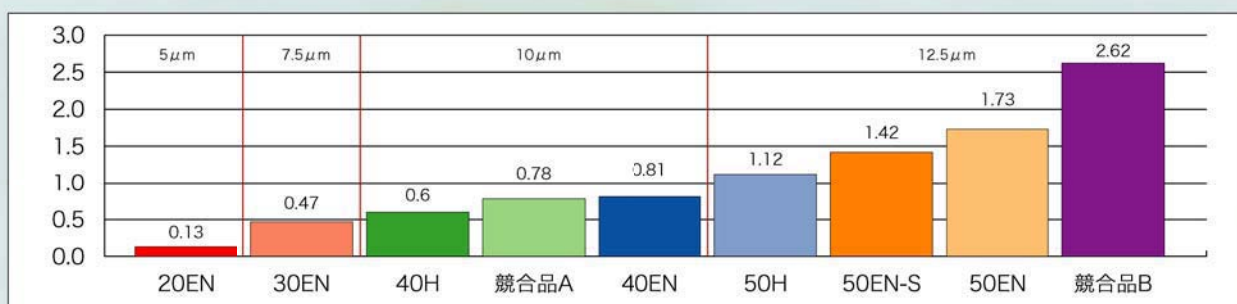
カプトン®20ENの特長

- 業界最薄である5 μ m厚のポリイミドフィルムの開発に成功
- FPCの低反発化、電子機器の軽量化・小型化・薄膜化が可能
- 熱抵抗が小さいため、放熱テープにも最適

基本物性表

項目	単位	20EN (新製品)	30EN	50EN	50H	100H	測定法
フィルム厚さ	(μ m)	5	7.5	12.5	12.5	25	—
強度	(MPa)	335	335	380	360	350	JIS C 2318
伸度	(%)	55	58	62	80	82	JIS C 2318
ヤング率	(GPa)	5	5	5	3	3	ASTM D-882
CTE	(ppm/ $^{\circ}$ C)	16	16	16	27	27	50~200 $^{\circ}$ C昇温速度10 $^{\circ}$ C/min
絶縁破壊電圧	(kV/mm)	398	398	392	411	375	JIS 2318
絶縁破壊電圧	(kV)	2.1	3.0	4.9	5.1	9.4	JIS 2318
熱抵抗	($^{\circ}$ C \cdot /W)	0.28	0.42	0.69	0.78	1.6	—
熱伝導率 (厚さ方向)	(W/mk)	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	—

スティフネス値 (mN/cm)



FPCのスプリングバック試験例

